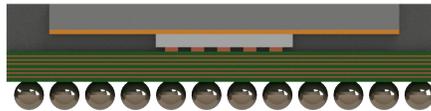


适用于 fcCSP 封装的 硅集成散热片

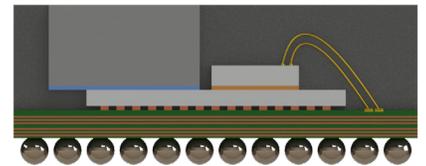
硅可以有效替代铜作为散热片材料。

- ▶ 由于热传导性佳，而且加工简单，硅可以有效替代铜作为散热片材料
- ▶ 硅集成散热片 (IHS) 可被嵌在模塑内部，其顶部暴露并与外部散热器接触

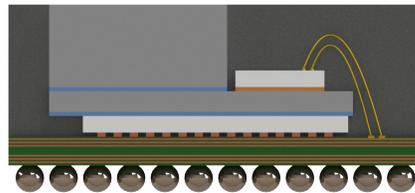
结构示例包括：



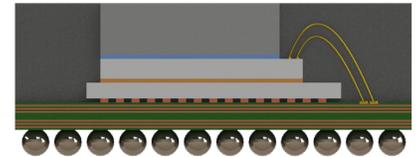
单晶粒 fcCSP 中的
嵌入式与外露式硅 IHS



并排混合结构中的
嵌入式和外露式 Si IHS



混合结构中的双硅 IHS



堆叠混合结构中的
嵌入式和外露式硅 IHS

硅集成散热片的考虑因素

Amkor 的封装增强体可被嵌在模塑内部，其顶部暴露并与外部散热器接触。

关键点

- | | | | |
|---|---------------|---|----------|
|  | 硅集成散热片 (IHS) |  | 倒装芯片晶粒凸块 |
|  | 热界面材料 (TIM) |  | 焊线指形焊点 |
|  | 活性硅 (倒装芯片或焊线) |  | 基板 |
|  | 焊线晶粒贴装材料 |  | 焊球 |
| | |  | 焊线 |

访问 amkor.com 或发送电子邮件至 sales@amkor.com 以获得更多信息。

